

PCBA 除助焊剂

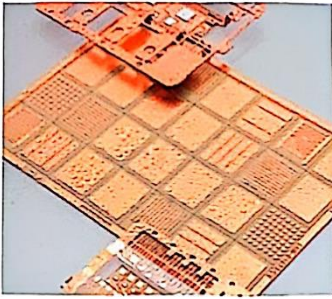
ZESTRON水基型和溶剂型清洗剂适用于去除 PCBA板的助焊剂。我们的产品组合涵盖多种清洗技术。在所有常见清洗工艺中,能够卓越清洗即使是最新面市的锡膏和助焊剂。pH值中性和碱性清洗剂,为任何类型的组件和基板提供绝佳材料兼容性的清洗解决方案。

产品技术	清洗剂	应用领域			
		PCB (FR4) / 多层板	柔性 PCB	厚膜混合电路	铝基材料
MPC [®] (水基型)	VIGON [®] A 201	●	●	●	
	VIGON [®] N 600	●	●	●	●
	VIGON [®] N 640	●	●	●	●
	VIGON [®] N 680	●	●	●	●
	VIGON [®] PE 180	●	●	●	●
	VIGON [®] PE 190A	●	●	●	●
	VIGON [®] A 200	●		●	
	VIGON [®] US	●		●	
	VIGON [®] A 250	●		●	
	FAST [®] (水基型 表面活性剂)	ATRON [®] AC 205	●	●	●
ATRON [®] AC 207		●	●	●	
HYDRON [®] WS 400		●	●		
溶剂	ZESTRON [®] FA+	●	●	●	●
	ZESTRON [®] VD	●	●	●	●
	ZESTRON [®] CO 150	●	●	●	●
	ZESTRON [®] DW	●	●	●	●
	VIGON [®] EFM	●		●	●

- 专用 - 该产品专为此类应用研发设计
- 适用 - 该产品推荐用于此类应用

如您需要了解更多有关清洗液监控,表面分析以及清洗液回收再利用等信息,请查阅工艺优化产品手册。





功率电子除助焊剂

ZESTRON的产品组合主要针对功率电子,如功率模块/DCB、引线框架和分立器件,包括水基型和溶剂型清洗液,适用多种清洗技术。每种产品都有绝佳的清洗性能和材料兼容性。对于任何材料,如敏感金属、裸芯片和钝化层,pH值碱性和中性的清洗液都能提供清洗解决方案,并对铜基板有出色的去氧化能力,从而为后续的引线键合或塑封成型提供最佳工艺条件。

产品技术	清洗剂	应用领域		
		汽车高功率LED	DCB / 功率模块 IPM / IGBT	引线框架 / 分立器件
MPC [®] (水基型)	VIGON [®] PE 200	●	●	●
	VIGON [®] PE 215N	●	●	●
	VIGON [®] PE 180	●	●	●
	VIGON [®] PE 190A	●	●	●
	VIGON [®] N 600	●	●	●
	VIGON [®] A 200		●	●
	VIGON [®] A 201	●		
	VIGON [®] A 250	●		
HYDRON [®] (单相,水基型)	HYDRON [®] SE 220	●	●	●
	HYDRON [®] SE 230A	●	●	●
FAST [®] (水基型 表面活性剂)	ATRON [®] AC 205	●		
	ATRON [®] AC 207	●	●	●
溶剂	ZESTRON [®] FA+	●	●	●
	ZESTRON [®] DW	●	●	●
	ZESTRON [®] VD			●
	ZESTRON [®] CO 150		●	●

- 专用 - 该产品专为此类应用研发设计
- 适用 - 该产品推荐用于此类应用

如您需要了解更多有关清洗液监控,表面分析以及清洗液回收再利用等信息,请查阅工艺优化产品手册。





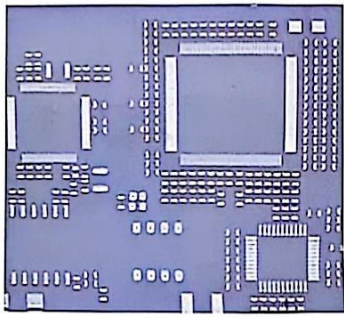
封装及晶圆清洗

ZESTRON 针对先进封装行业提供多款水基型和溶剂型清洗剂, 专注于倒装芯片、SiP和 CMOS 的芯片粘接之后, 底部填充、引线键合和塑封之前, 以及晶圆凸块之后的助焊剂去除。卓越的低底部间隙清洗性能以及与多种材料的兼容性是关键的产品特性, 确保合适的、无空洞的底部填充润湿, 高质量的引线键合、预防塑封成型分层或晶圆凸块的侵蚀。

产品技术	清洗剂	应用领域					
		SiP	倒装芯片 BGA / 2.5/3D TSV	BGA	单个组件 即 CoB, MEMS	CMOS 镜头模组	晶圆
MPC [®] (水基型)	VIGON [®] N 600	●	●	●	●		
	VIGON [®] A 201	●	●	●	●	●	
	VIGON [®] A 250	●	●	●	●	●	
	VIGON [®] US	●	●	●	●	●	
HYDRON [®] (单相, 水基型)	HYDRON [®] SE 220	●	●	●	●	●	●
	HYDRON [®] SE 230A	●	●	●	●	●	●
FAST [®] (水基型 表面活性剂)	ATRON [®] AC 205	●	●	●	●	●	
	ATRON [®] AC 207	●	●	●	●		
溶剂	ZESTRON [®] FA+	●	●	●	●	●	

- 专用 - 该产品专为此类应用研发设计
- 适用 - 该产品推荐用于此类应用





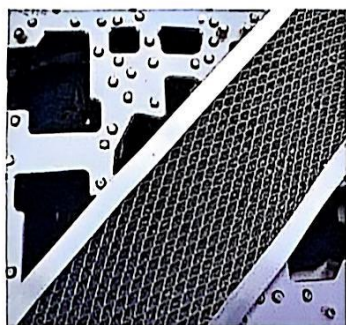
SMT 钢网、丝网和误印板清洗

完整的水基和溶剂型清洗剂产品线适用于去除钢网和丝网上的锡膏，以及针对SMT贴片胶、厚膜浆料、导热化合物和特定工艺的专用解决方案，如SMT印刷机的网板底部擦拭或误印板清洗。

清洗技术	清洗剂	应用领域						
		助焊剂	锡膏	SMT 贴片胶	厚膜浆料	导热化合物	SMT印刷机网板底部擦拭	刮刀
MPC [®] (水基型)	VIGON [®] SC 200	●	●	●			●	●
	VIGON [®] SC 202	●	●	●				●
	VIGON [®] SC 210	●	●	●				●
	VIGON [®] SC	●	●	●			●	●
	VIGON [®] UC 160		●				●	
	VIGON [®] TC 150					●		●
HYDRON [®] (单相, 水基型)	HYDRON [®] SC 300	●	●	●			●	●
溶剂	ZESTRON [®] SD 100		●				●	●
	ZESTRON [®] SD 301	●	●	●	●		●	●
	ZESTRON [®] SW		●	●			●	
	ZESTRON [®] SD 300	●	●	●	●		●	●

- 专用 - 该产品专为此类应用研发设计
- 适用 - 该产品推荐用于此类应用





焊接夹具、冷凝器&工具清洗

ZESTRON 提供一整套水基型、表面活性剂型和溶剂型清洗剂, 专用于去除焊接夹具、冷凝器、载具、焊锡炉、点胶针头、刮刀、涂覆框架及其他设备部件上被烘烤后的助焊剂和由于焊接工艺导致的逸出物质以及焊接前的锡膏以及SMT贴片胶。

产品技术	清洗剂	应用领域							
		自动清洗设备	手动清洗	冷凝器	焊接夹具、 载具、框架	设备零部件	回流炉 波峰焊系统	点胶针头 贴片吸嘴	涂覆框架
FAST [®] (水基型 表面活性剂)	ATRON [®] SP 200	●		●	●	●			
	ATRON [®] SP 300	●		●	●	●			
	ATRON [®] SP 400	●		●	●	●			
水基型	ATRON [®] DC	●						●	
MPC [®] (水基型)	VIGON [®] RC 303		●		●	●	●		
	VIGON [®] SC 210	●						●	
溶剂	ZESTRON [®] HC		●					●	

- 专用 - 该产品专为此类应用研发设计
- 适用 - 该产品推荐用于此类应用



环境、健康与安全规范



ZESTRON 所有的清洗产品均符合RoHS I & II / WEEE、GHS / CLP及REACH法规的相关标准,且不包含 SVHC 或S.I.N. 清单的任何物质。只有最环保且保证人员安全的原材料才会被使用。

如需更多信息和文件,请联系我们:
infochina@zestron.com

清洗技术 & 品牌



溶剂型清洗技术 - ZESTRON

ZESTRON® 系列产品是专为高端清洗应用研发的现代溶剂型清洗剂。具有宽大的工艺窗口去除各种污染物,长使用寿命,相比简单醇类或卤化溶剂能达到最高健康安全标准。



FAST® 快效表面活性剂技术 - ATRON

ATRON® 系列的产品基于快效表面活性剂技术的新生代表面活性剂。特别是在较短的接触时间以及高污染负载的情况下,较之于传统表面活性剂具备无与伦比的清洗性能。



MPC® 微相清洗技术 - VIGON

VIGON® 系列产品基于微相清洗技术。该无闪点、低VOCs含量的水基无表面活性剂产品具有宽大的应用窗口和很长的使用寿命,有效降低运营成本。



单相清洗技术 - HYDRON

HYDRON® 系列产品是水基单相清洗剂,在不同清洗工艺限制和工艺处理过程的情况下具有出色的工艺窗口。很好的可漂洗性并能很容易过滤,以确保长使用寿命及低运营成本。

其他可用产品信息

- » 技术信息
包括产品应用、优点及物理数据
- » 材料兼容性
包括零部件和清洗设备的材料兼容性概述
- » 化学品安全说明书
关于成分、操作注意事项、运输和储存的相关信息
- » MPC® 技术资料
关于水基型清洗技术的信息
- » FAST® 技术资料
关于表面活性剂型清洗技术的信息
- » HYDRON® 技术资料
关于水基型单相清洗技术的信息

